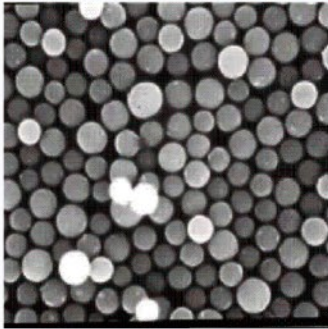


## MSP-Nシリーズ(開発品)



日興リカの超微粒子球状シリコンパウダーは、シロキサン結合が三次元的に結合した構造(RSiO<sub>3</sub>/2)を持つポリメチルシルセスキオキサン微粒子です。

一般の有機系ポリマーと比較して耐熱性に優れており、また多くの有機溶剤に溶解しません。

**用途** 半導体封止剤：低応力化、耐湿性向上  
レジストインキ：耐クラック性  
光学用途：光拡散効果

### 一般特性

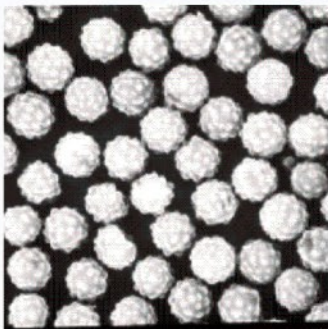
項目	製品名	MSP-N030
外観		真球状 白色微粉末
平均粒子径(μm)		0.3
加熱減量(200°C、60min)(wt%)		1.0
比表面積(m <sup>2</sup> /g)		220
真比重		1.3

(規格値ではありません)

### MSPシリーズ

グレード	平均粒子径(μm)
MSP-N030	0.3
MSP-N050	0.5
MSP-N080	0.8

## Silcrustaシリーズ(開発品)



Silcrusta MK02

Silcrustaシリーズは、アクリル、ポリスチレン、ポリウレタンなどの有機樹脂粒子をシロキサン結合が三次元的に結合した構造(RSiO<sub>3</sub>/2)を持つポリメチルシルセスキオキサンで被覆した複合粒子です。

真球状粒子からなる粒子表面に突起を有する金平糖状粒子があり、コア/シェル型構造からなる光屈折差を利用した光学用途、さらに金平糖状粒子ではその特異な形状効果により光拡散性や平滑性に優れた効果を発揮します。

**特長**

- ・従来の有機樹脂粒子単体と比べ耐熱性に優れている。
- ・高光透過性、光拡散性に優れる。
- ・耐溶剤性に優れる。

**用途** 各種プラスチックの光学特性向上